

公司概況資料表

以下資料由家碩科技股份有限公司及其推薦證券商提供，資料若有錯誤、遺漏或虛偽不實，均由該公司及其推薦證券商負責。

以下揭露之認購價格及依據等資訊，係申請登錄興櫃公司與其推薦證券商依認購當時綜合考量各種因素後所議定。由於興櫃公司財務業務狀況及資本市場將隨時空而變動，投資人切勿以上開資訊作為投資判斷之唯一依據，務請特別注意

認購相關資訊

公司簡介

風險事項說明(申請登錄戰略新三板公司適用)

主要業務項目

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

最近五年度簡明資產負債表

最近三年度財務比率

公司名稱：家碩科技股份有限公司 (股票代號：6953)

申請登錄： 一般板 戰略新三板

董事長	邱銘乾
總經理	詹印豐
資本額	新台幣272,976,000元
輔導推薦證券商	元大證券股份有限公司、合作金庫證券股份有限公司、永豐金證券股份有限公司、凱基證券股份有限公司
主辦輔導券商聯絡人電話	元大證券股份有限公司 葉玟秀(02)2718-1234 分機6797
註冊地國	(外國發行人適用)
訴訟及非訟代理人	(外國發行人適用)

輔導推薦證券商認購家碩科技股份有限公司股票之相關資訊

證券商名稱	主辦	協辦	協辦	協辦
	元大證券	合作金庫證券	永豐金證券	凱基證券
認購日期	112/6/16			
認購股數(股)	<u>619,000</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>	<u>100,000</u>
認購占擬櫃檯買賣股份總數之比率	<u>2.27%</u>	<u>0.37%</u>	<u>0.37%</u>	<u>0.37%</u>
認購價格	<u>120</u>	<u>132</u>	<u>132</u>	<u>132</u>

目前股票價格的評估方法諸多，而各種方法皆有其優缺點，評估之結果亦有所差異。證券投資分析常用之股票評價方法主要包括：

- (1)市場法：本益比法(Price/Earnings Ratio, P/E Ratio)及股價淨值比法(Price/Book Value Ratio, P/B Ratio)，均透過已公開的資訊，與整體市場、產業性質相近的同業及被評價公司歷史軌跡比較，作為評量企業的價值，再根據被評價公司本身異於採樣公司之部分作折溢價之調整。
- (2)成本法：係以帳面歷史成本資料作為公司價值評定之基礎。
- (3)現金流量折現法：採用未來現金流量作為公司價值之評定基礎。

以上股票評價方法，成本法係以歷史成本為計算之基礎，易忽略通貨膨脹因素且無法反映資產實際之經濟價值，且深受財務報表所採行之會計原則與方法之影響，將可能低估成長型公司應有之價值；現金流量折現法下某些假設，如未來營收成長率、邊際利潤率、資本支出之假設等，在產業快速變化下對未來之預估甚難準確，使未來現金流量及加權平均資金成本無法精確掌握；股價淨值比法較適用於獲利不穩定，或成熟產業但獲利波動劇烈的景氣循環公司，而該公司屬獲利穩定之產業，故本推薦證券商僅就本益比法作為評估基準。

家碩科技股份有限公司(以下簡稱家碩或該公司)主要從事半導體設備機台之研發及銷售。經參考國內已上市櫃從事半導體設備機台及零備件公司之同業資料，選擇業務型態、產品性質、公司規模及營業項目較為相近者作為採樣同業：(1)京鼎(上市公司，股票代號3413)主要營業項目為半導體設備、次系統及系統整合(2)華景電(上櫃公司，股票代號6788)主要營業項目為半導體設備及系統整合(3)天虹(興櫃公司，股票代6937)主要營業項目為半導體設備及相關零組件之研發、生產與銷售。

茲彙總採樣同業最近三個月(112年3月~5月)之平均本益比如下：

單位：倍

採樣同業	月份	112年 3月	112年 4月	112年 5月	平均
京鼎		8.28	7.82	8.66	8.25
華景電		14.63	13.44	12.18	13.42
天虹		31.80	33.21	32.33	32.45
上市股票-半導體業		12.77	12.09	13.94	12.93
上櫃股票-半導體業		17.58	17.07	19.91	18.19

資料來源：財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心及證券交易所網站

由上表得知，採樣同業及上市櫃半導體業類股最近三個月(112年3月~112年5月)之平均本益比約介於8.25~32.45倍之間，惟去除極端值32.45後之平均本益比約介於8.25~18.19倍之間；另依據該公司最近四季(111年第二季~112年第一季)之稅後淨利228,444千元，以目前股數27,298千股計算，每股稅後盈餘為8.37元，按上述本益比區間計算其參考價格，其參考價格區間約為69.05~152.25元，故主辦及協辦推薦證券商股票認購價格分別為每股120元及132元，介於合理價格區間內，認購價格尚屬合理。

綜上所述，本次興櫃認購價格之訂定除參酌國際慣用之各項評價法計算家碩之合理價格，並考量該公司之經營績效、獲利情形、所處市場環境、產業未來成長性，由本推薦證券商與該公司共同議定之興櫃認購價格，尚屬合理。

認購價格
之訂定依
據及方式

公司簡介(公司介紹、歷史沿革、經營理念、未來展望等)

一、公司介紹

家碩科技股份有限公司於民國105年由上櫃公司家登精密工業股份有限公司轉投資設立，家碩公司目前主要從事半導體傳載自動化之技術解決方案。半導體機台設備包含光罩潔淨、交換及檢測，以及微環境儲存及智慧倉儲管理，致力改善生產線製程，提昇良率，提高自動化設備生產。另外，家碩公司於109年收購昇和精技股份有限公司，主要從事半導體製程用物理氣相沈積設備及相關零組件之製造及銷售，借此將業務觸角延伸到 PVD 真空鍍膜和 PVD 設備技術，以期兼蓄半導體和面板的 PVD 真空技術，擴展核心技術。截至112/5/31止實收資本額為新臺幣272,976千元。

二、歷史沿革

年 度	重要紀事
105	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司設立，實收資本額17,500千元。 ➤ EUV 微環境充氣製程技術研發，並成功導入到 EUV 製程市場。
106	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 現金增資 17,000 千元，累計實收資本額 34,500 千元。
107	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 開發光罩儲存管理設備，成功導入國際大廠應用。
108	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 成功開發高階光罩潔淨設備，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。 ➤ 開發光罩交換設備，成功導入國際大廠應用。
109	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 盈餘轉增資 20,700 千元，累計實收資本額 55,200 千元。 ➤ 成功開發 EUV 微環境充氣倉儲，技術延伸整合廠區管路系統。 ➤ 擴廠搬遷至台南樹谷園區。 ➤ 收購昇和精技(股)公司，業務觸角延伸至 PVD 真空鍍膜及相關設備技術。
110	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 登記資本總額變更為 5 億元，盈餘轉增資 55,200 千元，累計實收資本額 110,400 千元。 ➤ 推出 EUV 光罩智慧檢測設備，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。 ➤ 成功開發 EUV 光罩高潔淨技術，取得國際客戶認證，導入應用。 ➤ 成功開發光罩傳送驛站，導入美系半導體大廠之製造整合應用。
111	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 成功開發 EUV 光罩交換與長期儲存方案，取得 SEMI S2 認證並導入市場應用。 ➤ 成功以 EUV 光罩交換設備導入美系記憶體大廠應用。 ➤ 推出 EUV 倉儲整合自動化系統，導入國際大廠應用。 ➤ 產品及技術服務拓展至國際大廠之美洲及東亞廠區。 ➤ 產品及技術服務拓展至美系大廠之東南亞廠區。 ➤ 盈餘轉增資 55,200 千元，累計實收資本額 165,600 千元。 ➤ 現金增資 60,000 千元，累計實收資本額 225,600 千元。
112	<ul style="list-style-type: none"> ➤ 公司更名為家碩科技股份有限公司。 ➤ 產品及技術服務拓展至美系大廠之歐洲及西亞廠區。

三、經營理念

家碩科技專注於本業之經營，重視技術之研發及業務行銷之拓展，建立以人才為本、成果共享、永續經營的企業經營理念，並專注於整合技術能力，以提供客戶高品質的服務及產品，與供應商及客戶一同成長。

四、未來展望

(1)短期業務發展計畫

- A.持續深耕關鍵客戶，提供整合性技術解決方案。
- B.擴建技術團隊，鞏固專利壁壘，以厚植技術能力。
- C.與供應商協同合作，提升品質，建立互惠共生夥伴關係。
- D.持續製程管理進化，建立高效穩定、品質優異之製造系統。

(2)長期業務發展計畫

- A.以「深耕關鍵客戶」、「開拓新客戶」、「發展新市場」三大策略重點聚焦發展，擴大創新服務效益，協助客戶成功。
- B.以智慧工廠自動化技術發展為目標，虛實整合精密機械技術與自動化控制技術，開創製造新層次。
- C.建構堅實完整之供應鏈，以垂直多角化模式策略及技術聯盟供應體系，共創產業價值。

TOP^

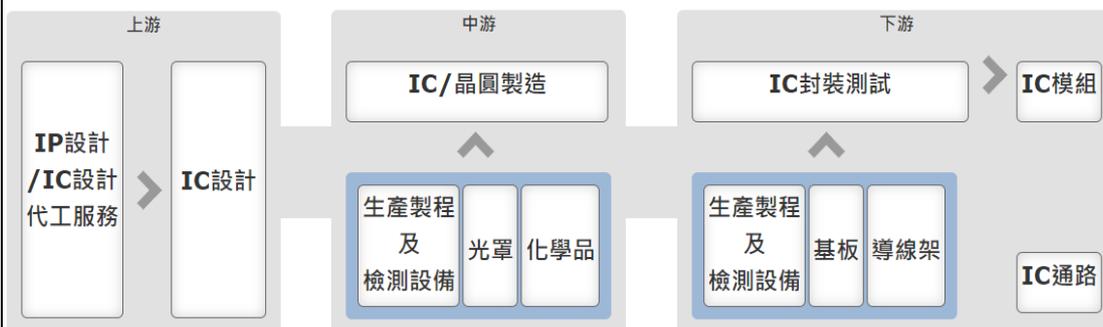
TOP^ 主要業務項目：

主要係從事半導體設備及相關零組件之設計、製造、銷售及維修服務，其中主要包括應用於 EUV 光罩及高階光罩傳載自動化之技術解決方案。

公司所屬產業之上、中、下游結構圖：

半導體產業主要由上游 IC 設計廠商開始發展，接著中游 IC 製造、晶圓製造及相關製程與檢測設備等廠商相互配合及分工，將晶圓廠做好的晶圓，以光罩印上電路基本圖樣，再依靠各工段之製程設備，如氧化、擴散、蝕刻、沉積及離子植入等方法，將電路及電路上的元件，在晶圓上製作出來。該公司為半導體製程設備製造商，即為中游廠商。最後，由下游廠商進行 IC 封裝，即將晶圓切割後的晶粒，用塑膠、陶瓷或金屬包覆，藉以保護晶粒免受碰撞及污染，且易於裝配，並達成晶片與電子系統的電性連接與散熱效果。

茲將其上、中、下游關聯性列示如下：



資料來源：產業價值鏈資訊平台

產品名稱	產品圖示及介紹	重要用途或功能	111年度 營收金額(千元)	佔總營收 比重(%)
EUV 光罩設備		主要係應用於 EUV 之光罩儲存設備、光罩交換機、光罩清潔等功能性設備。	582,544	55.59
高階光罩設備		主要係應用於高階製程之光罩儲存設備、光罩交換機、光罩清潔等功能性設備。	357,628	34.13
其他		主要係設備零件之買賣及維修服務等。	107,781	10.28
合計			1,047,953	100.00

TOP ^

最近五年度簡明損益表及申請年度截至最近月份止之自結損益表

單位：新臺幣千元

項目	年度	107年	108年	109年	110年	111年	112年截至4月份止 (自結數)(註)
營業收入		155,849	219,290	477,773	601,932	1,047,953	389,792
營業毛利		62,119	93,105	156,597	215,994	450,879	171,193
毛利率(%)		39.86	42.46	32.78	35.88	43.02	43.39
營業外收入		472	318	4,905	51	13,168	1,705
營業外支出		(77)	(1,676)	(5,023)	(22,294)	(139)	(214)
稅前損益		19,560	32,139	79,663	90,960	255,358	96,761
稅後損益		15,216	25,682	63,663	67,532	203,415	77,353
每股盈餘(元)		0.92	1.55	3.84	4.08	11.91	3.43
股利發放	現金股利(元)	5.22	-	-	-	2.00	-
	股票股利(資本公積轉增資)(元)	-	-	-	-	-	-
	股票股利(盈餘轉增資)(元)	-	6.00	10.00	5.00	2.10	-

註1：各年度財務資料業經會計師查核簽證。該公司107~109年僅編製採我國企業會計準則之個體報表，該公司於109年12月31日收購昇和精技公司100%之股權，故107~108年度無須編製合併財務報告；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

註2：係自結數字，未經會計師查核簽證，因此可能與會計師查核結果存有差異，請投資人於參考時審慎評估。

最近五年度簡明資產負債表

單位：新台幣仟元

年度		107年	108年	109年	110年	111年
項目						
流動資產		186,597	420,975	561,900	922,123	1,578,449
基金及長期投資		-	-	-	-	-
固定資產		2,449	2,231	12,868	12,407	15,421
無形資產		776	604	11,631	7,966	4,301
其他資產		1,100	1,364	48,631	32,489	36,259
資產總額		190,922	425,735	635,030	978,978	1,655,098
流動負債	分配前	116,526	343,814	489,446	765,862	1,083,569
	分配後	116,526	343,814	489,446	765,862	1,083,569
長期負債		149	-	-	-	20,960
其他負債		-	-	-	-	-
負債總額	分配前	116,675	343,814	489,446	765,862	1,104,529
	分配後	116,675	343,814	489,446	765,862	1,104,529
股本		34,500	34,500	55,200	110,400	225,600
資本公積		34,500	34,500	19,457	19,457	93,495
保留盈餘	分配前	20,290	27,964	70,927	83,259	231,474
	分配後	20,290	27,964	70,927	83,259	231,474
長期股權投資 未實現跌價損失		-	-	-	-	-
累積換算調整數		-	-	-	-	-
股東權益總額	分配前	74,247	81,921	145,584	213,116	550,569
	分配後	74,247	81,921	145,584	213,116	550,569

註1：各年度財務資料業經會計師查核簽證。該公司107~109年僅編製採我國企業會計準則之個體報表，該公司於109年12月31日收購昇和精技公司100%之股權，故107~108年度無須編製合併財務報告；該公司自110年度起適用國際財務報導準則並編製合併財務報表，附列109年度比較數字。

TOP ^

最近三年度財務比率

年度		109年	110年	111年
項目				
財務比率	毛利率(%)	32.78	35.88	43.02
	流動比率(%)	114.80	120.40	145.67
	應收帳款天數(天)	64	41	63
	存貨週轉天數(天)	263	337	324
	負債比率(%)	77.07	78.23	66.73

TOP ^

投資人若欲查詢該公司更詳細之資料請連結至[公開資訊觀測站!!](#)